**MSK 有机硅阻燃导热灌封胶 MR6619-1.0AB**

**产品描述**

MR6619 是一种导热性能好，流动性能优异的高导热有机硅电子灌封胶。其在固化前具有较低的粘度，两个组分混合后既可以室温固化，也可加温固化，温度越高固化越快，固化时材料无收缩。该产品通过对电子元件进行灌封以有效的防止水分、尘埃及有害气体对电子元器件的侵入，减缓振动，防止外力损伤和稳定元器件参数，将外界的不良影响降到最低。同时，导热材料的运用可以有效的使电路产出的热得以扩散，阻止线路热量集中，温度上升，从而延长电子器件的使用寿命。

 **产品典型性能参数:**

**产品特点和优点**

* 流动性好，易灌封
* 导热效果好
* 线收缩率低
* 100%固体，无固化副产物
* 使用温度-50℃~200℃
* UL 94 V-0（E469464）

**应用**

* 功率模块
* 大功率电源模块
* 控制器
* 逆变器
* 车用电子产品

**应用方法**

使用时将 A，B 按照 1：1 的比例混合均匀，浇注在需要 灌封的部位。产品有良好的自排泡性能，一般直接灌封即可达到 需要的散热效果，抽真空后再灌封，导热效果更佳。灌封完成后根据具体工艺条件，室温加热固化均可。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 性能 | MR6619-1.0 | 测试标准 |
| 未固化性能 |
| 颜色 | 灰色 | 目视 |
| 混合粘度/mPa·s | 2000±300 | ASTM D1084 |
| 操作性能 |
| 操作时间/min@25℃ | 30~40 | —— |
| 表干时间/h@25℃ | 2 | —— |
| 初步固化/h@25℃ | 4~6 | —— |
| 固化时间/min@80℃ | 30 | —— |
| 固化后性能 |
| 硬度/邵A | 50±5A | ASTM D2240 |
| 导热系数/W·m-1k-1 | 1.0 | ASTM D5470 |
| 介电强度/kV/mm | ≥20 | ASTM D149 |
| 体积电阻率/Ω·cm | ≥1X10 14 | ASTM D257 |
| 阻燃等级 | V-0 | UL 794 |

**注意事项**

本产品属于加成型固化硅橡胶，遇到以下物质会影响或阻碍产品的固化： 含有锡（Sn2+）、铅（Pb2+）、汞（Hg2+）等重金属离子的化合物；有机锡以及含有机锡的硅酮胶；含 N、S、P 的有机化合物；某些不饱和碳氢增塑剂等。

**包装规格**

20kg/桶，40kg/组。

**储存**

在 30℃以下密封保存，A、B 组分的有效期为自生产日期后十二个月。存放时间超过三个月，导热粉体会有沉降现象，使用前搅拌均匀，不影响产品使用性能。